

高電流密度対応硫酸銅めっき添加剤

Additives for Acid Copper Plating under High Current Density

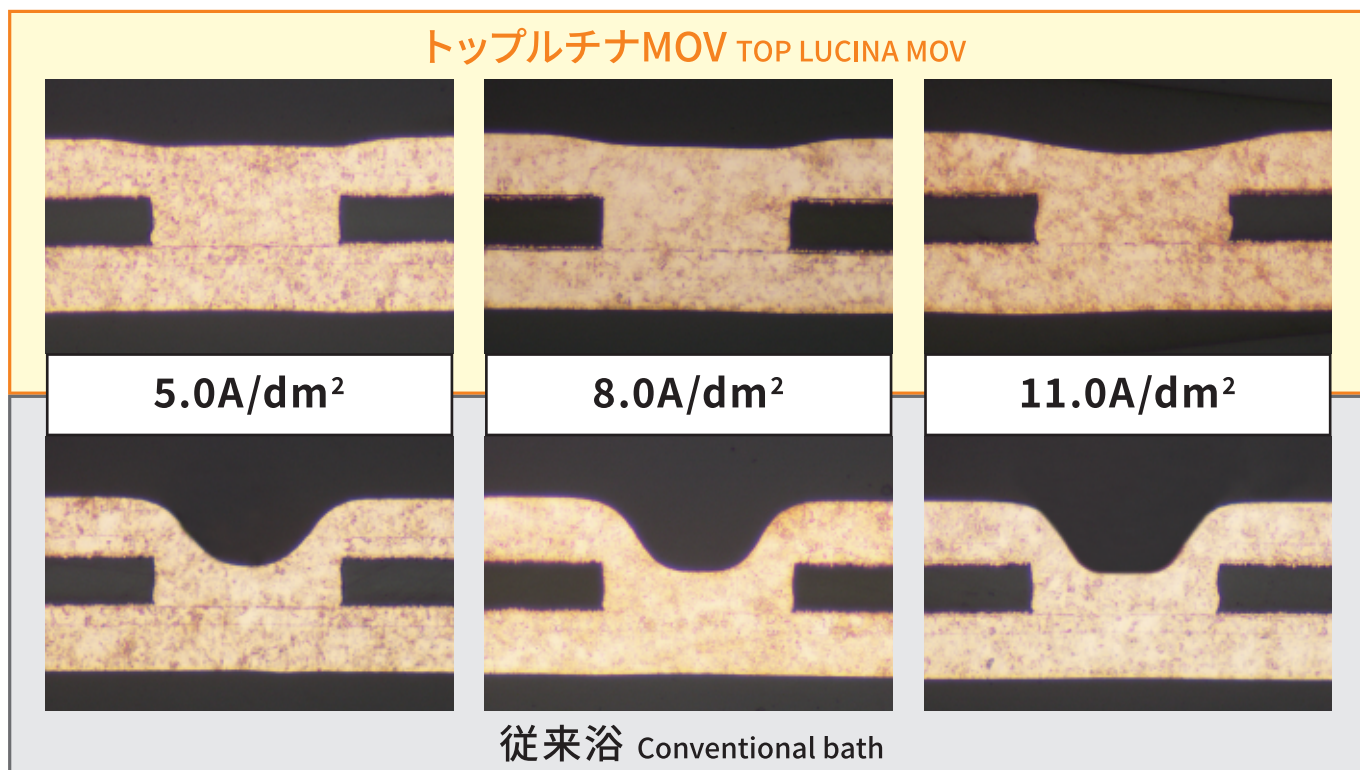
トップルチナMOV

TOP LUCINA MOV

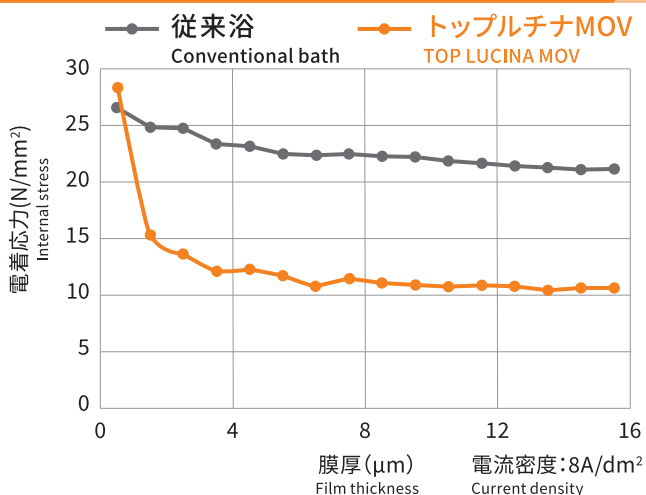
- 優れたビアフィリング性能を発揮
Can show great via-filling performance
- 全ての添加剤成分の定量分析が可能
Quantitative analysis is possible for all additives
- 幅広い電流密度(1~11A/dm²)に対応
Applicable to wide current density (1 to 11A/dm²)

従来浴よりも高電流密度におけるフィリング性能が向上
Improve filling performance at higher current density than conventional baths

ビア径 Hole diameter : 100μm ビア深さ Hole depth : 35μm 銅箔厚 Copper foil thickness : 10μm



内部応力が低い Low internal stress



付きまわり性に優れる Great covering power

